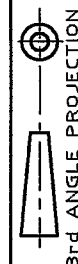


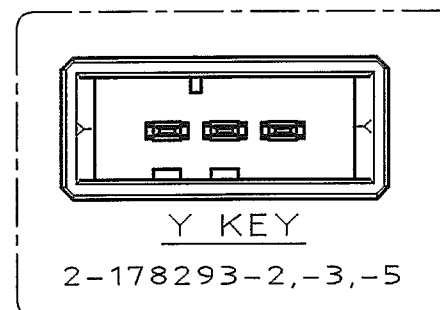
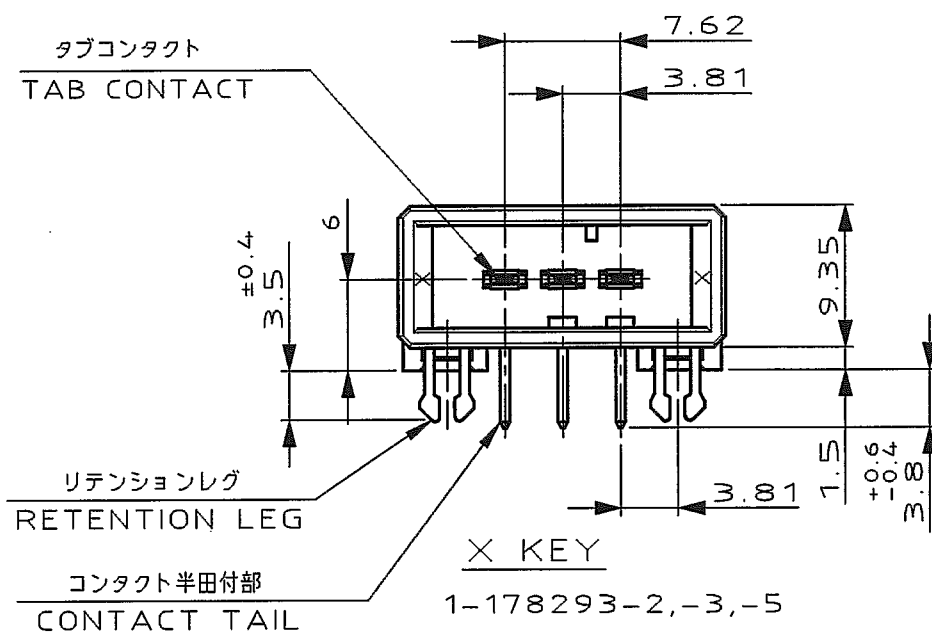
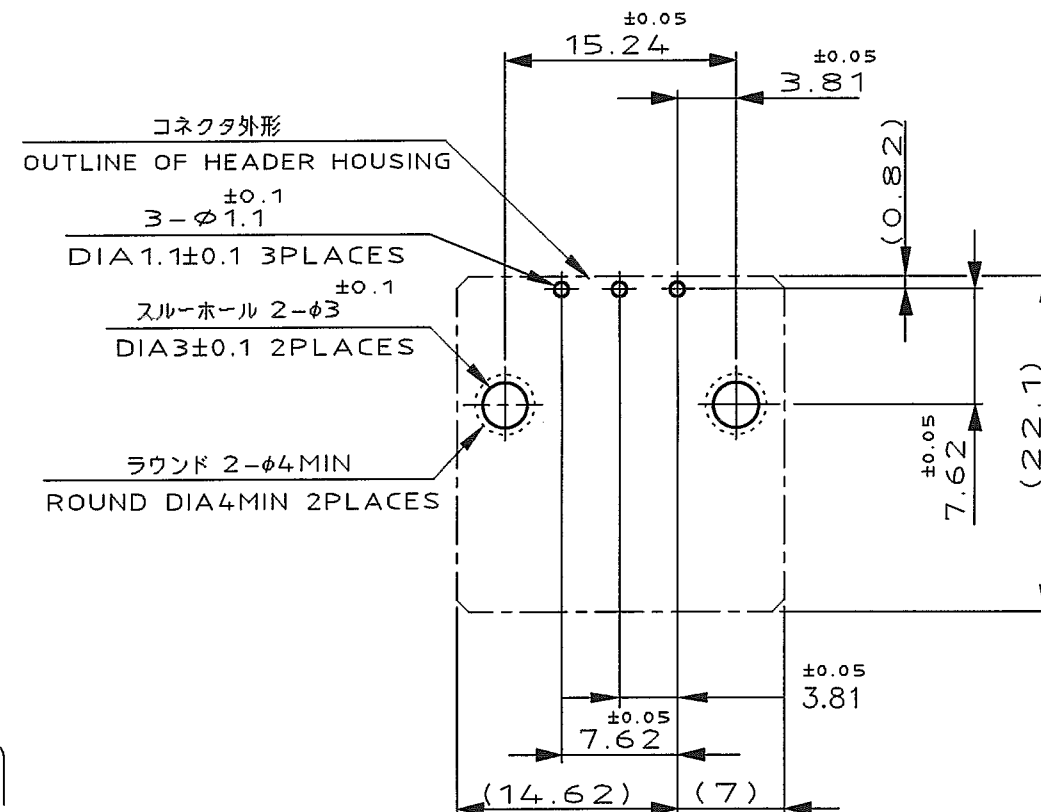
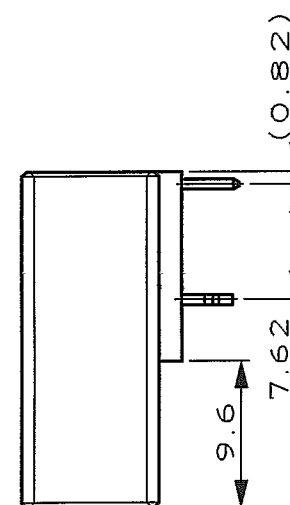
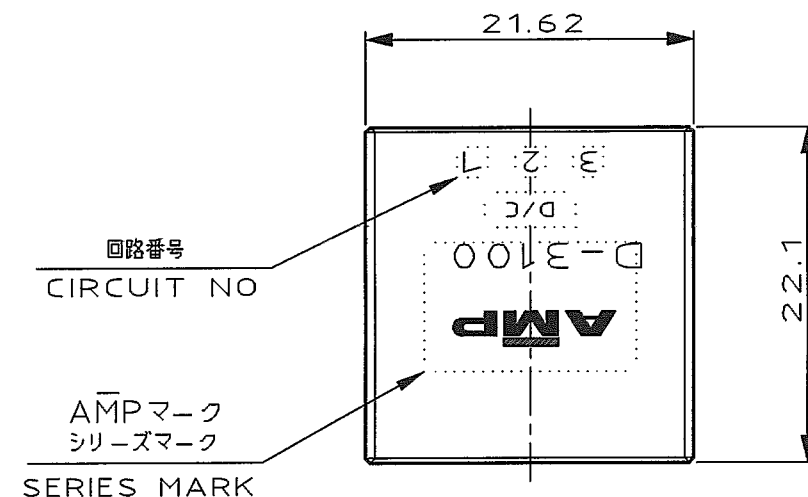
NUMBER 178293



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1,2-178293-5
△6	△3	1,2-178293-3
△6	△2	1,2-178293-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14APR 11	DR. 20/MAR/95 K.IKEDA	DE. 20/MAR/95 K.IKEDA
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK. 23/MAR/92 S. MANABE	APP. 23/MAR/92 S. MANABE

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
mm (AWG)	mm	
MATERIAL	FINISH	
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	

3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
10mm : ±0.3 10mm 3mm : ±0.4 30mm 100mm : ±0.5 角度 : ±3°	A3	J	C=178293
SCALE	REV.	C1	SHEET
2-1			1 OF 1

